

公司代码：603893

公司简称：瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：以2025年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），预计派发现金红利总额为505,193,520.00元，资本公积不转增。公司2025年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

此外，公司于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于<利润分配预案>的议案》，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），并于2026年2月10日实际派发现金红利126,287,550.00元。

综上，公司2025年度合计向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），拟合计派发现金红利631,481,070.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.72%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	瑞芯微	603893	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林玉秋	翁晶
联系地址	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼	福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区18号楼

电话	0591-86252506	0591-86252506
传真	0591-86252506	0591-86252506
电子信箱	ir@rock-chips.com	ir@rock-chips.com

2、 报告期公司主要业务简介

（一）行业基本情况及政策

1、 公司所处行业基本情况

公司为集成电路设计企业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。

集成电路行业上游主要包括半导体材料和设备、芯片设计工具等，中游主要为集成电路设计、制造、封装和测试等环节，下游主要包括通信、消费电子、汽车电子、工业应用等各领域应用。集成电路产业链绵长复杂，行业发展呈现技术和资本密集、分工精细化与专业化、政策驱动性强、全产业链协同创新等特征。集成电路行业作为信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，也是驱动新质生产力的关键引擎，其技术水平和发展规模已成为衡量国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。

2、 报告期内行业发展趋势

2025年，全球半导体行业在人工智能、高性能计算、数据中心基础设施建设等需求的拉动下，保持强劲增长态势。人工智能技术的快速发展推动大模型升级迭代加速，全球大模型厂商竞争持续加剧。为保持大模型领先地位、抢占大模型产业化先机，以中美头部科技公司为代表的企业在大模型算力基建上持续超高投入。随着AI基础设施投资爆发，用于AI服务器的HBM、DRAM等存储芯片需求指数级增长，推动存储市场进入量价齐升的超级周期。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2025年全球半导体市场规模达7,956亿美元，同比增幅扩大至26.2%，主要得益于AI计算芯片等逻辑IC与存储芯片的强劲涨势。

作为全球半导体行业的重要参与者，2025年中国半导体行业创新加速，景气度持续上行。2025年1月，DeepSeek-R1发布，通过模型架构和训练方法创新，以少量算力投入实现顶尖推理性能，大幅降低大模型训练与推理成本。同时，开源模式降低行业门槛，加速AI在教育、医疗、工业等垂直应用领域全面落地。根据工信部数据显示，2025年我国集成电路产量4,843亿块，同比增长10.9%；集成电路设计收入4,421亿元，同比增长18.9%，展现了中国集成电路产业强大的韧性与活力。根据海关总署数据显示，2025年我国集成电路出口数量3,495亿个，同比增长17.4%；出口总额2,019亿美元，同比增长26.8%，我国集成电路产品在国际市场上的竞争力持续增强。

3、 报告期内行业主要政策情况

集成电路行业作为国家重点鼓励、扶持的新兴战略产业，过去一年来国家各部委围绕财税金融支持、标准制定、核心技术攻关、场景应用创新等方面出台了多项政策，致力于推动集成电路行业高质量发展。其中，报告期内新发布的主要政策如下：

2025年3月，《2025年政府工作报告》明确提出2025年持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。

2025 年 3 月，国家发改委等五部门联合印发《关于做好 2025 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》，延续对符合要求的集成电路企业和软件企业的税收优惠政策。

2025 年 3 月，工信部印发《2025 年工业和信息化标准工作要点》，提出要加强制造业智能化赋能标准建设，落实《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》，加快数据服务、智能芯片、智能传感器、计算设备、算力中心等基础支撑标准研制等。

2025 年 8 月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确到 2027 年，率先实现人工智能与 6 大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 70%；到 2030 年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超 90%。

2025 年 9 月，工信部等四部门联合印发《关于开展 2025 年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作的通知》，延续对符合要求的集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业的增值税加计抵减政策。

2025 年 10 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

2025 年 11 月，国务院办公厅发布《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，指出在人工智能领域，加强关键核心技术攻关和推广应用，加快高价值应用场景培育和开放，更好满足科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等各领域发展需要。

（二）公司所处的行业地位

公司是国内人工智能物联网 AIoT 芯片领先者，获得国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家知识产权优势企业的认定。公司深耕大规模集成电路设计二十余年，拥有深厚的技术底蕴和丰富的行业市场经验，围绕“大音频、大视频、大感知、大软件”的技术发展方向不断迭代创新，保持核心技术水平的领先性，持续深耕 AIoT 市场各应用领域，致力于为下游客户提供最佳的芯片解决方案，助力人工智能全方位赋能千行百业。

2025 年 4 月，公司获得汽车电子产业投资联盟颁发的“年度汽车产业链突破奖（2024-2025）”。

2025 年 5 月，公司 RK3588M 凭借高性能高算力及丰富的量产案例，荣获第十二届汽车电子创新大会（AEIF2025）金芯奖评选的“卓越产品奖”。

2025 年 10 月，公司凭借在具身智能领域前瞻性的技术布局、全栈式的芯片解决方案及高效的产业落地成果，成功入选“2025 高工具身智能年度力量榜”。

2025 年 11 月，公司轻量级 AI 处理器 RK3562 荣获第二十届“中国芯”优秀市场表现产品奖。

（三）公司主要业务及经营模式

公司是国内领先的 AIoT 芯片设计企业，主营业务为智能应用处理器 SoC 及周边配套芯片的设计、研发与销售。针对芯片行业高投入、技术迭代快的特点，公司采用 Fabless 经营模式，即公司集中资源投入到芯片研发和创新设计，将晶圆的制造与封装、测试环节委托给专业代工企业，最终取得芯片成品进行对外销售并向客户提供技术服务。针对 AIoT 应用领域广泛、客户群体庞大的特点，公司采用以经销为主、直销为辅的销售模式，通过整合外部

渠道资源实现市场的广域覆盖和快速扩张。

（四）公司的主要产品及其用途

公司主要产品包括智能应用处理器芯片、数模混合芯片及其他芯片，其中 2025 年智能应用处理器芯片收入 39.27 亿元，占比 89.21%。公司构建了多元化的智能应用处理器芯片平台，并通过开放易用的工具链、深度合作的算法生态以及可快速复用的行业参考设计，建立“芯片+算法+行业方案”的全栈能力，产品广泛应用于汽车电子、机器视觉、机器人、工业应用、教育办公、商业金融、智能家居、消费电子以及运营商等下游众多领域，是目前国内 AIoT 产品线布局最丰富、客户覆盖范围最广的厂商之一。

1、智能应用处理器芯片

智能应用处理器芯片，属于系统级芯片（SoC）范畴，是系统级超大规模数字集成电路，通常内置 CPU、GPU 作为基础运算核心，并根据应用场景集成 NPU、ISP、视频编解码等处理内核，通过单芯片实现计算、图像处理、AI 等能力，主要用于各类型智能终端设备的核心运算与应用处理，是支撑各类智能功能实现的“大脑”。其中，NPU 核心功能是高效执行神经网络计算，与 CPU 和 GPU 相比，在处理 AI 任务上具有更高的能效比、更低的延迟和更强的场景适配性等优势，是端侧 AI 应用的核心算力支撑。

公司的智能应用处理器芯片通用性强、产品梯队丰富，部分产品还推出工业规格及车用规格等专用版本，具有可靠性高、抗干扰性强等优势。根据功能侧重方向，可将公司的智能应用处理器划分为通用处理器、视觉处理器、音频处理器等。通用处理器包括 RK3588 系列、RK3576 系列、RK3568/66 系列、RK3562 系列、RK3399 系列、RK3288 系列、RK3326 系列、RK3506 系列等，拥有不同性能层次的 CPU、GPU 内核，具备强大的数据处理能力、出色的性能表现、良好的系统兼容、丰富的数据接口配置等技术优势，充分满足下游多场景应用需求。视觉处理器包含 RV1126B 系列、RV1106/03 系列、RV1106B/03B 系列等，根据产品定位集成 NPU、ISP、AI-ISP、视频编解码器等自研核心 IP，支持丰富的视觉算法，具有良好的影像处理能力，适用于多场景下的机器视觉应用。音频处理器包含 RK2118 系列、RK2116 系列等，内置高性能音频 DSP，具有灵活的音频接口和丰富的外设扩展，广泛应用于 Soundbar 音箱、调音台、会议拾音设备、车载功放等多形态产品。

公司自 2018 年以来持续迭代自研 NPU，目前大部分智能应用处理器芯片已内置 NPU 模块。其中，RK3588 系列、RK3576 系列、RK3572 系列集成 4~6TOPS 中高算力 NPU，RV1126B 系列、RK3568/66 系列、RK3562 系列等集成 1~3TOPS 中等算力 NPU，RV1106/03 系列、RV1106B/03B 系列、RK2118 系列等集成 1TOPS 以下轻量级算力 NPU，形成不同算力的产品梯队，充分满足 AIoT 不同场景、产品应用对性能和算力的差异化需求。同时，因应 AI 在端侧应用的发展需求，公司重点布局 16TOPS 及以上的大算力芯片产品，已于 2025 年推出全球首颗 3D 架构协处理器 RK182X，能够有效解决终端产品部署端侧大模型面临的带宽、功耗等关键瓶颈，是部署端侧 AI 最合适的解决方案。

2、数模混合芯片及其他芯片

公司的数模混合芯片及其他芯片主要包括电源管理芯片、接口转换芯片、无线连接芯片等产品。其中，电源管理芯片如 RK860 系列、RK80X 系列、RK81X 系列等，主要承担电能变换、分配、检测及其他电能管理职责；接口转换芯片如 RK628 系列等，主要用于实现不同接口或传输协议间数据转换的功能；无线连接芯片如 RK96X 等，主要用于实现设备之

间无线通信的功能。这些芯片通常与公司的智能应用处理器芯片灵活搭配，为客户提供稳定、高效的综合产品解决方案。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减 (%)	2023年
总资产	5,584,701,847.04	4,265,988,219.99	30.91	3,507,219,550.74
归属于上市公司股东的净资产	4,382,394,945.78	3,545,884,291.91	23.59	3,060,740,090.06
营业收入	4,402,090,888.24	3,136,370,678.42	40.36	2,134,522,147.19
利润总额	1,117,773,300.01	611,854,701.42	82.69	82,214,571.54
归属于上市公司股东的净利润	1,039,952,125.00	594,862,210.27	74.82	134,885,044.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,008,919,084.65	538,394,517.62	87.39	126,319,259.19
经营活动产生的现金流量净额	1,068,773,781.48	1,379,383,589.99	-22.52	681,258,029.87
加权平均净资产收益率(%)	25.79	17.81	增加7.98个百分点	4.53
基本每股收益(元/股)	2.48	1.42	74.65	0.32
稀释每股收益(元/股)	2.46	1.42	73.24	0.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	884,962,635.69	1,160,880,454.93	1,095,538,404.08	1,260,709,393.54
归属于上市公司股东的净利润	209,479,446.98	321,666,635.93	248,430,805.42	260,375,236.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	207,948,152.69	307,803,536.78	240,231,896.68	252,935,498.50
经营活动产生的现金流量净额	311,552,612.60	396,772,233.78	138,980,023.52	221,468,911.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

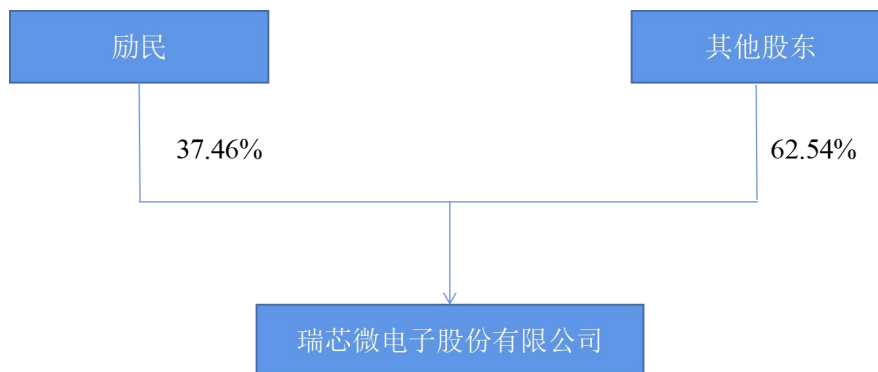
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							99,563
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							96,175
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	报告期内	期末	比例	持有有限	质押、标记或	股东	

(全称)	增减	持股数量	(%)	售条件的 股份数量	冻结情况		性质
					股份 状态	数量	
励民	0	157,679,892	37.46	0	无	0	境内自然人
黄旭	0	62,430,000	14.83	0	无	0	境内自然人
厦门市润科欣投资管理合 伙企业(有限合伙)	-8,368,300	19,900,640	4.73	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	165,987	10,244,052	2.43	0	无	0	境外法人
厦门腾兴众和投资合伙企 业(有限合伙)	-2,271,700	5,038,493	1.20	0	无	0	境内非国有法人
厦门普芯达投资合伙企业 (有限合伙)	-1,770,400	4,047,084	0.96	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公 司—华泰柏瑞沪深 300 交 易型开放式指数证券投资 基金	3,463,346	3,463,346	0.82	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司— 万家行业优选混合型证券 投资基金(LOF)	-999,945	3,000,056	0.71	0	无	0	其他
厦门芯翰投资合伙企业 (有限合伙)	-1,235,600	2,817,237	0.67	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公 司—华夏国证半导体芯片 交易型开放式指数证券投 资基金	-565,314	2,654,703	0.63	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

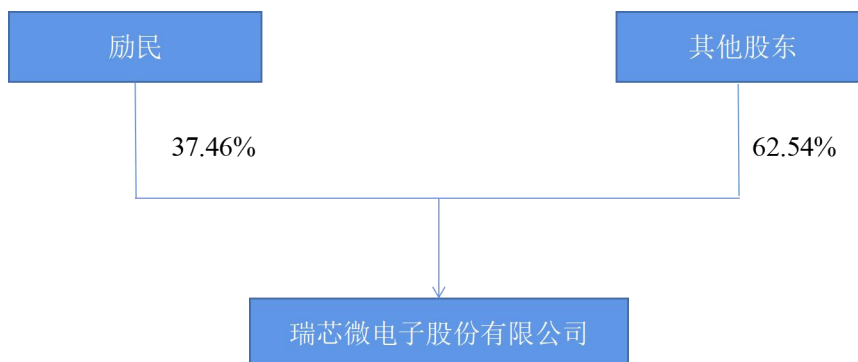
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 4,402,090,888.24 元，同比增长 40.36%；归属于上市公司股东的净利润 1,039,952,125.00 元，同比增长 74.82%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用